**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **北京敏光科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **34.05.00** |
| **教师姓名** | | **郭丹丹** | | **专业** | **34.05.00** | **培训地点** | **公司会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **曲晓莉** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | **技术开发服务流程图**  客户需求调研----签订服务协议及合同----技术开发计划制定---实施-----考核评价--- ---交付-----反馈-----卷宗归档  **销售服务流程**  销售计划管理----客户开发---销售定价-----销售合同审批与合同订立----提供服务------ 售后服务 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 公司编制了《与产品和服务有关评审控制程序》、《外包控制程序》、《服务控制程序》、《变更控制程序》和《顾客满意度控制程序》 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **不涉及** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 中华人民共和国招标投标法2.中华人民共和国合同法3.中华人民共和国产品质量法4. GB/T15651-1995半导体器件分立器件和集成电路第5部分：光电子器件 5. GB/T15651.2-2003半导体器件分立器件和集成电路第5-2部分:光电子器件基本额定值和特性 6. GB/T15651.3-2003半导体器件分立器件和集成电路第5-3部分:光电子器件测试方法 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 在电子产品研发过程中产品（服务）的监视和测量货物检验采购物资：市场开发部负责编制各类检测要求，应明确检验的项目、内容、方法、判定等，对采购的物资，市场开发部根据交货单对其进行验证后报检，由质检员负责对采购产品进行检验，将检验和验证结果填写《进货检验记录》。提供了2018.9.22电子产品为LDIP-TP-850-100P的激光器和LSSPD-1.2-L1系列光电探测器LDIP-TP-850-100P激光器的《进货检验记录》  如因急需来不及验证而放行，需经总经理批准，由检验人员做出明确的未检标识并填写《紧急/例外放行记录》，并确保发现不符合产品需要时，能立即追回和更换。  货物的验证方式：验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。检验依据《检验规程》进行过程检验和试验，并填写《生产过程检验记录》。在所要求的各项检验完成或必需的报告，报告收到和验证前不得将产品放行，如例外放行，必须有可靠的追回程序，才可放行。最终检验所有的过程检验完成后，由质检人员依据《检验规程》对成品进行最终检验，并填写《产品出厂检验记录》，并加盖检验者检验章。 | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | |

**填表人(专业人员)：郭丹丹 日期： 2010.12.10 审核组长： 曲晓莉 日期：2020.12.10**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**